

Alpha-Fry™ EGP-120

无卤素免清洗焊膏

描述

Alpha-Fry™ EGP-120 的焊膏专为无铅及锡铅应用而设。是一种免清洗、ROLO 配方的焊膏，专为电路板元件表面贴装的高可靠性焊点而设计。该产品化学成分与 SAC305(96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu)、SAC0307(99%Sn/0.3%Ag/0.7%Cu) 或锡铅合金例如 Sn63Pb37(63%Sn/37%Pb)兼容。该产品能实现良好的印刷性能，元件粘附力能承受标准的贴片流程并在回流时有优异的焊接特性。

技术规范

项目	规格
10 rpm, Malcom 粘度: 1) 88.6% 金属含量, SAC305 (96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu) 2) 88.6% 金属含量, SAC0307 (99%Sn/0.3%Ag/0.7%Cu) 3) 90% 金属含量, Sn63Pb37 (63%Sn/37%Pb)	1) 1700 poise 2) 1600 poise 3) 1300 poise
粘附力 (JIS 标准)	> 100 gf
网板寿命	> 8 小时
热塌陷 (JIS 标准)	合格
焊接残留颜色	透明淡黄色
焊球测试 (JIS 标准)	合格
卤素含量	无刻意添加
卤素和卤化物含量	无卤素/无卤化物
铜腐蚀性测试 (JIS-Z-3197-1999-8.41)	合格
表面绝缘阻抗 (IPC J-STD 004B)	合格
电子迁移测试 (JIS-Z-3197-1999 8.5.4)	合格
保质期 (0 -10°C, 开罐使用前放置室温条件下)	6 个月
包装规格	500 gm 罐装

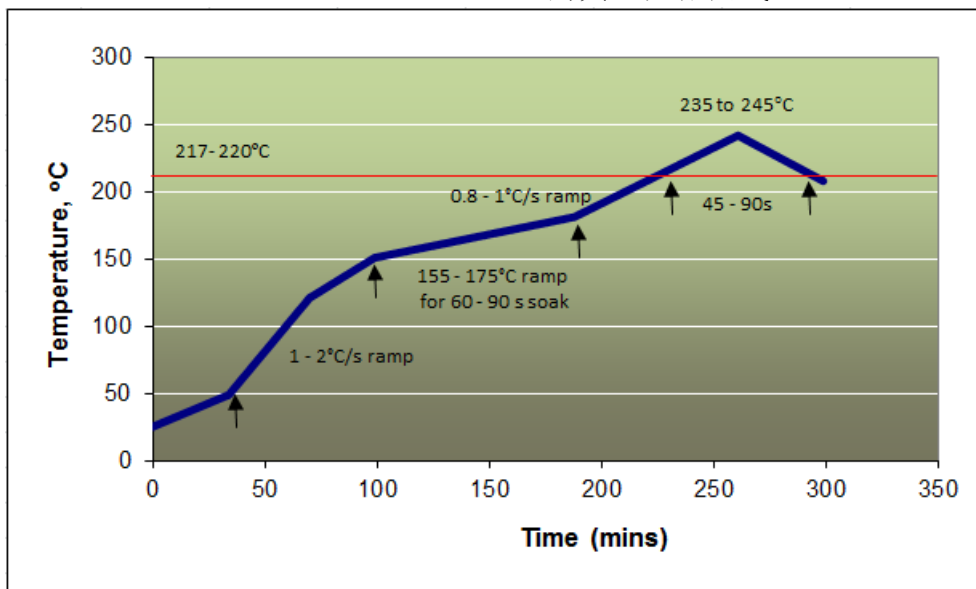
应用

印刷*
刮刀压力: 0.21 – 0.36 kg/cm 速度: 50 – 100 mm/s 焊膏滚筒直径: 1.5 – 2.0 cm 分离速度: 1 – 5 mm/s 提升高度: 8 – 14mm

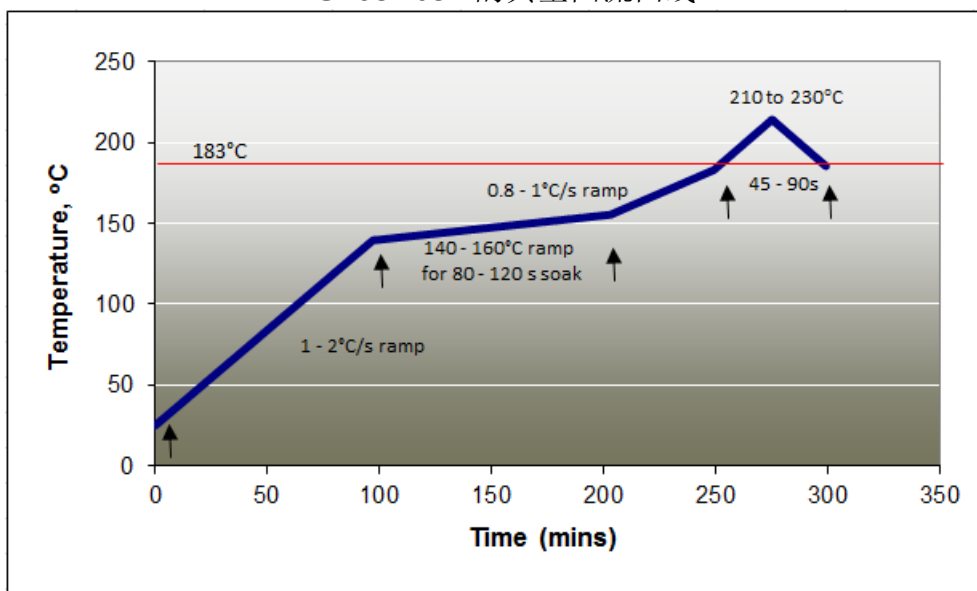
*适用于 0.10mm - 0.15 mm (4 - 6 mil 厚度和 0.4 - 0.5 mm (0.016" - 0.020")间距网板

回流	
无铅(图表 1)	锡铅(图表 2)
干燥空气或氮气 初期升温速度: 1-2°C/s 保温时间 (155 - 175°C): 60-90 秒 液相点上停留时间: 45-90 秒 峰值温度: 235-245°C 冷却速度: 3-7°C/s	干燥空气或氮气 初期升温速度: 1-2°C/s 保温时间 (140 - 160°C): 80-120 秒 液相点上停留时间: 45-90 秒 峰值温度: 210-230°C 冷却速度: 2-5°C/s

图表 1. Alpha-Fry™ EGP-120
SAC305 & SAC 0307 的典型回流曲线



图表 2. Alpha-Fry™ EGP-120
Sn63Pb37 的典型回流曲线



健康和安全性

遵守标准的操作使用规范，如在通风良好的使用环境以及避免长时间或反复的皮肤接触。穿戴合适的防护工装能有效防止与皮肤和眼睛接触。

欲了解更多信息，请参考材料安全数据表。